

チップエミフィル 大電流対応 部品材料表
Structure of Chip EMIFIL for Large Current
NFM3DPC223R1H3□ type

1. 使用材料 / Material

No.	品名 / Item	材料一般名 / Material
①	誘電体 Ceramic dielectric	セラミック誘電体 Ceramic dielectric
②	外部電極 Outer electrode	銅 + ニッケルめっき + 錫めっき Cu + Ni plating + Sn plating
③	内部電極 Inner electrode	ニッケル Ni

2. 内部構造 / Example of Structure

